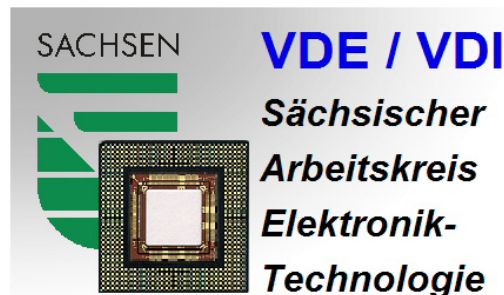


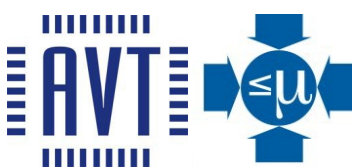
Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>



87. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Thema: **30 Jahre ZmP – Wegweisende Packaging-Forschung am IAVT & ZmP**

Datum: **Mittwoch, 25. November 2026**

Ort: **TU Dresden
Werner-Hartmann-Bau
Nöthnitzer Straße 66
01187 Dresden**

Programm (Stand 24.09.2026):

Bis 10:00 Uhr **Individuelle Anreise und Check In**

10:00 Uhr **Begrüßung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und Juliana Panchenko (TU Dresden, IAVT) und Martin Oppermann (TU Dresden, ZmP)**

10:15 Uhr **Strategische Perspektiven für die Zukunft von IAVT und ZmP**
Juliana Panchenko – TU Dresden, IAVT

11:00 Uhr **Charakterisierung von Sinterverbindungen mittels Multi-Energie-Radiographie**
Oliver Albrecht – TU Dresden, IAVT

11:30 Uhr **Kaffeepause**

11:45 Uhr **Thermo-mechanische Zuverlässigkeit von Flip-Chip-Lotkontakten unter harschen Umgebungsbedingungen – Experimente und Simulationen**
Karsten Meier – TU Dresden, IAVT

12:15 Uhr **Innovationen in der Leiterplatte**
Mathias Nowotnick – Universität Rostock, Inst. für Gerätesysteme und Schaltungstechnik

13:00 Uhr **30 Jahre ZmP – Personen, Projekte, Ideen**
Martin Oppermann – TU Dresden, ZmP

13:45 Uhr **Schlussworte**

14:00 Uhr **Gedankenaustausch und Ausklang bei Häppchen und Getränken**

Ende der Veranstaltung ca. 16:30 Uhr.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an martin.oppermann@tu-dresden.de bis **spätestens Montag, 16.11.2026 17:00 Uhr.**